

### KB-6167F 板材清单 (Laminate List)

Thickness 厚度 (mm)	Size 尺寸 (Inch)	Copper foil Type 铜箔类型
0.05-3.20	37" x49" , 41" x49" , 43" x49" 74" x49" , 82" x49" , 86" x49"	Reverse treated copper foil RTF铜箔 : 1/3OZ—6OZ HTE copper foil HTE铜箔 : 1/3OZ—6OZ

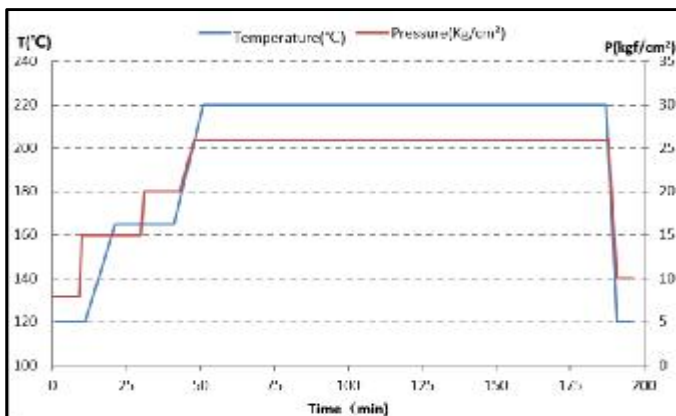
### KB-6067F 半固化片清单 (Prepreg List)

UL Designation UL型号	PP style 类型	R/C(%) 树脂含量	Dk±0.2(1GHz) 介电常数	Df±10%(1GHz) 介质损耗	Thickness(mil) 压合厚度
KB-6067F	1037	74±2	4.0	0.017	2.0±0.30
		76±2	4.0	0.017	2.1±0.30
	106	72±2	4.1	0.017	2.1±0.30
		73±2	4.0	0.017	2.2±0.40
	1067	74±2	3.9	0.018	2.2±0.40
		71±2	4.1	0.017	2.5±0.40
	1080	74±2	4.0	0.017	2.8±0.40
		62±2	4.3	0.016	2.8±0.30
	1086	64±2	4.2	0.017	3.0±0.40
		68±2	4.2	0.017	3.4±0.40
	2116	60±2	4.3	0.016	2.9±0.30
		64±2	4.3	0.016	3.3±0.40
	1506	52±2	4.5	0.015	3.5±0.30
		55±2	4.4	0.015	3.8±0.30
	7628	58±2	4.4	0.016	4.2±0.40
		53±2	4.5	0.016	4.7±0.40
	7628	55±2	4.5	0.016	5.0±0.40
		58±2	4.4	0.016	5.4±0.50
	7628	46±2	4.6	0.015	6.2±0.40
		50±2	4.5	0.016	6.8±0.50
7628	43±2	4.7	0.015	7.3±0.40	
	45±2	4.6	0.015	7.7±0.50	
7628	48±2	4.6	0.016	8.3±0.50	

### KB-6067F 半固化片储存 (Prepreg Storage)

储存条件(Condition)	有效期(Shelf Life)
Max. 50%RH & Max. 23°C 湿度 < 50% 及 温度 < 23°C	90 days
Max. 5°C(Normal in room temperature for at least 4h before using) 温度 < 5°C (拆包装前需在室温下回温至少4小时)	180 days

### 压合参数 (Recommended Process)



- Heat-up rate: 1.0-2.5 °C/ min (80 °C-140 °C)  
热压升温速率: 1.0-2.5 °C/ min (80 °C-140 °C)
- Curing time: >60min (>190 °C)  
固化时间: >60min (>190 °C)
- Curing pressure: 25±5 kgf/ cm<sup>2</sup>  
(Vacuum Hydraulic Press)  
固化压力: 25±5 kgf/ cm<sup>2</sup>  
(真空液压机)